

SCHEDA TECNICA

ZM-R7220A SISTEMA DI REWORK PER PACKAGE ARRAY, LED E BGA

Sistema semi automatico per la rilavorazione di schede SMT che montano dai micro chip al grid array di grandi dimensioni e più complesso. Il pannello touch screen e lo schermo in alta risoluzione agevolano il lavoro dell'operatore, mentre un sistema di controllo automatico della testa di rifusione protegge i circuiti più delicati. I cicli di rifusione per la saldatura e dissaldatura, sono in grado di riprodurre le condizioni ideali per la salvaguardia dei circuiti e dei componenti più sensibili. La telecamera HD azionabile manualmente offre immagini di superba qualità.

Caratteristiche di base:

- Testa di reflow ad aria calda
- Preriscaldamento doppio (aria e IR)
- Temperatura ultra controllata
- Precisione sensore 2-3°C
- Allineamento ottico di precisione
- Telecamera CCD HD 1.3Mp
- Ingrandimento 5X-50X
- Touch screen ad alta risoluzione
- Posizionamento semi automatico
- Saldatura e Dissaldatura



Specifiche Tecniche:

Alimentazione/Potenza Assorbita	220VAC 50/60 Hz Max 5900W
Potenza riscaldatori ad aria	Superiore 1200W, inferiore 1200W
Potenza pre-riscaldatore IR	2700W IR a riscaldamento rapido
Temperatura dell'aria calda	400°C max
Posizionamento accurato	Con sensore di pressione
Precisione dell'allineamento	0,01 mm
Min/Max dimensione della scheda	22 x 22 mm / 415 x 370 mm
Min/Max dimensione dei componenti	2 x 2 mm / 50 x 50 mm
Adatta per componenti	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, micro SMD
Dimensioni e peso	640 (L) x 630 (P) x 920 (H) mm, 78 kg
Certificazione	CE

DATA SHEET

ZM-R7220A REWORK SYSTEM FOR PACKAGE ARRAY, LED AND BGA

Automatic system for the rework of SMT boards ranging from micro chips to large and more complex grid arrays. The touch screen panel and high resolution screen facilitate the operator's work, while an automatic control system of the reflow head protects the most delicate circuits. The automatic reflow cycles for soldering and desoldering are able to reproduce the ideal conditions for safeguarding the most sensitive circuits and components. The manually operated HD camera offers superb image quality.

Basic Features:

- Hot air reflow head
- Double preheating (air and IR)
- Temperature control Ultra
- Sensor accuracy 2-3°C
- Precision Optical Allignment
- CCD HD Camera 1.3Mp
- Magnification 5X-50X
- High Resolution Touch Screen
- Semi Automatic Positioning
- Soldering and Desoldering



Technical Specifications:

Power Supply/Power Consumption	220VAC 50/60 Hz Max 5900W
Power air heaters	Upper 1200W, Lower 1200W
IR pre-heater Power	2700W (IR fast heating)
Hot Air Temperature	400°C max
Precision Positioning	With pressure sensor
Alignment Precision	0.01 mm
Min/Max Board Dimensions	22 x 22 mm / 415 x 370 mm
Min/Max Components Dimensions	2 x 2 mm / 50 x 50 mm
Components	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, micro SMD
Dimensions and weight	640 (L) x 630 (P) x 920 (H) mm, 78 kg
Certification	CE